

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 12 日(12.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/046806 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 65/02 (2006.01) C08L 25/04 (2006.01)
B65D 73/02 (2006.01) C08L 51/04 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01) C08L 53/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/073105
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 6 日(06.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-227462 2010 年 10 月 7 日(07.10.2010) JP
特願 2010-286980 2010 年 12 月 24 日(24.12.2010) JP
特願 2011-020066 2011 年 2 月 1 日(01.02.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原 純平 (FUJIWARA Junpei) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 大澤 知弘(OSAWA Tomohiro) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 川田 正寿(KAWATA Masatoshi) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT PACKAGING SHEET, AND FORMED ARTICLE THEREOF

(54) 発明の名称: 電子部品包装用シート及びその成形体

(57) Abstract: Disclosed is an electronic component packaging sheet comprising a surface conductive layer formed on the surface of at least one side of a substrate sheet. The substrate sheet comprises: (A) 80,000-220,000 Mw of a styrene-conjugated diene block copolymer; (B) 200,000-400,000 Mw of a polystyrene resin; and (C) 150,000-210,000 Mw of an impact resistant polystyrene resin. The surface conductive layer comprises: (D) an acrylic copolymer resin; and (E) carbon nanotubes. The electronic component packaging sheet is a transparent conductive sheet having excellent thermoforming properties, good transparency after thermoforming, and sufficient electrostatic diffusion performance to maintain a low surface resistance value. The electronic component packaging sheet is particularly suited for the manufacture of embossed carrier tape.

(57) 要約: 本発明では、基材シートの少なくとも片側の表面に表面導電層が形成されてなる電子部品包装用シートにおいて、前記基材シートが、 $M_w = 80,000 \sim 220,000$ のスチレン-共役ジエンブロック共重合体 (A)、 $M_w = 200,000 \sim 400,000$ のポリスチレン樹脂 (B)、及び $M_w = 150,000 \sim 210,000$ の耐衝撃性ポリスチレン樹脂 (C) の各成分を含んでなり、表面導電層が、アクリル系共重合体樹脂 (D) とカーボンナノチューブ (E) を含んでなる、電子部品包装用シートが開示される。該シートは、熱成形性に優れ、成形後の透明性が良好で、かつ表面抵抗値が低く保たれる十分な静電気拡散性能を有する透明導電シートであり、特にエンボスキャリアテープの作製に好適に使用できる。

WO 2012/046806 A1